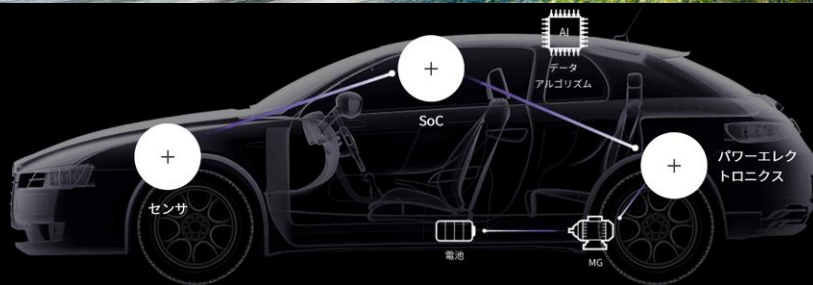


# ミライズテクノロジーズ

Mobility Innovative Research Institute for Semiconductor Technologies



## 主要研究分野

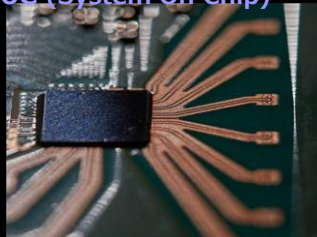
パワーエレクトロニクス



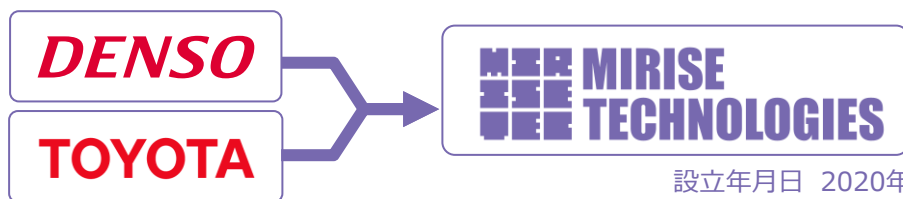
センサ



SoC (System On Chip)



## ■ (株)ミライズテクノロジーズとは 会社概要



設立年月日 2020年4月1日

## トヨタ、デンソー出資による車載半導体の研究会社

DENSO・TOYOTAの半導体研究部門から技術と研究員が集結

拠点	所在地	研究開発領域
本社	愛知県日進市 デンソー先端研究所内	パワエレ/センサ/SoC
刈谷ラボ	愛知県刈谷市 デンソー本社内	センサ
広瀬ラボ	愛知県豊田市 デンソー広瀬製作所内	パワエレ
品川ラボ	東京都港区 品川グランドセントラルタワー4F	センサ/SoC

採用情報\* デンソー会社案内



\* 株式会社デンソーでの採用となります  
詳しくは、デンソーのHPよりご確認ください

## 100年に一度の変革をリードする研究人材を求めます

# ミライズテクノロジーズ セミナー＋研究所見学

日時：2025年1月18日（土） 13:00～16:00

場所：愛知県日進市米野木町南山500-1

対象：26または27年卒業予定学生＋キャリア採用をお考えの方

内容：セミナー「自動車用半導体とミライズの研究内容」、研究所見学、社員との座談会

※交通費支給します

## 先進的な半導体エレクトロニクス技術でモビリティの新しい価値創造を目指します

「MIRISE Technologies」とは、“Mobility Innovative Research Institute for SEMiconductor Technologies”の頭文字です。世界のモビリティに革新を与える半導体開発を行い、未来をもっと進化・向上させていきたいという使命・熱い思いを含めました。また、“MIRAI（未来）”と“RISE（上昇）”を組み合わせた意味も含めています。

ミライズ テクノロジーズは、トヨタの持つモビリティ視点、ならびにデンソーが培ってきた車載視点での知見を掛け合わせることで、クルマ軸と部品軸の両輪で、電動車両や自動運転車両の技術革新の鍵となる次世代の車載半導体を、より早期に開発していきます。

ミライズ テクノロジーズの半導体エレクトロニクスがコアとなり、豊かな環境、安全と心地よさを合わせ持つモビリティ社会を実現することを目指していきます。

### 3つの主要研究分野

・パワーエレクトロニクス：現状のシリコンパワーデバイスの性能を大きく上回る、次世代、次々世代のSiC、Ga系、ダイヤモンドのパワーデバイスと、その応用技術の開発を進めています。さらなる「燃費の向上」や「部品の小型化」を実現し、電動車の普及に貢献します。

・センサ：将来のモビリティ社会において、道と人の状況を認識するセンサの重要性はますます高まっています。特に「自動運転」では、障害物や道路形状などの周辺環境を「広範囲」かつ「高精度」に認識することが必要不可欠です。この実現に向けてクルマ軸と部品軸の両輪でセンサ技術を進化させていきます。

・SoC：クルマにはより高度な電子システムが搭載されるようになり、これらを統制する基幹部品として「System on Chip」が注目されています。私たちは、より豊かな社会を実現するための車載SoCの研究開発を推進します。

### 募集職種

領域	職種	キーワード
パワーエ	パワー半導体のデバイス およびプロセス研究開発	Si、SiC、デバイス、プロセス 評価、分析、解析、信頼性、半導体製造設備
	パワー半導体の分析、解析、 信頼性評価技術研究開発	Si、SiC、デバイス、プロセス 評価、分析、解析、信頼性、分析設備、解析設備、信頼性評価設備
	パワー半導体モジュールの研究開発	パワーモジュール、パワー半導体SiC、GaN、TIM、焼結材、金属接合
	パワー半導体を使った回路・制御研究開発 次世代パワー半導体の 材料・デバイス・プロセス研究開発	インバータ、コンバータ、モータ制御、電源制御、マイコン、FPGA、ASIC、モデルベース SiC、GaN、酸化ガリウム、ダイヤモンド半導体、エピタキシャル成長、ALD
センサ	自動運転向け周辺監視センサの 企画/研究開発	ミリ波レーダ、LiDAR、カメラ、高周波回路、アナログ回路、光集積回路/シリコンフォト ニクス、深層学習/ディープラーニング
	自動運転/ドライバ支援向けセンサフュージョン の研究開発	AI、機械学習、深層学習/ディープラーニング、走路認識、ヒト状態推定、生体セン サー、ドライバーモニタリングシステム、DSM、センサーフュージョン
	将来モビリティ向け半導体センサ の研究開発	電池監視、慣性センサ、生体センサ、MEMS、アナログ回路 深層学習/ディープラーニング
SoC	車載SoCの企画・研究開発	マイコンアーキテクチャ、ソフトウェアPF、ミドルウェア開発(特にRTOS向け)、組み込みソ フトウェア、OS開発/設計、FPGA設計、GPU、SoC、SoC設計、FPGA、ハードIP、 車載マイコン、ソフトウェア、ハードアーキテクチャ

### PROFILE 会社概要

社名：株式会社 ミライズ テクノロジーズ

設立年月日：2020年4月1日

資本金：5,000万円

従業員数：523名（2024年3月31日現在）

出資比率：株式会社デンソー51%/トヨタ自動車株式会社49%

事業内容：車載半導体の研究・先行開発および  
半導体を用いた電子部品の開発

### 所在地

本社：〒470-0111 愛知県日進市米野木町南山500番地1

広瀬ラボ：〒470-0309 愛知県豊田市西広瀬町桐ヶ洞543

刈谷ラボ：〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1

品川ラボ：〒108-0075 東京都港区港南2-16-4  
品川グランドセントラルタワー4F

※(株)デンソーへ入社後、出向となります。

勤務時間、処遇、給与等の条件はすべてデンソーと同一です。

ぜひ、現地にて研究現場と研究者の生の声を体験ください